

Wafer Inspection System - INSPECTRA® Series

半导体业界最快速的晶圆全自动光学检测设备

- ✓ INSPECTRA® 系列满足半导体前后段制程高速、高精度的全自动检测需求！
- ✓ 独家 Die-to-Statistical-Image 的比较技术可有效降低缺陷检测过程中造成的损坏及误判率。



INSPECTRA® 产品信息

检测特点

功能	功能优势	应用效益
高分辨率的大范围检测	速度快，敏感度高	✓ 良好检测结果的高生产力
Die-to-Statistical-Image 算法	达成缺陷检测目标	✓ 控制流程变异及误幸
多款光学及硬件系统	提供光学检测解决方案	✓ 适用多种晶圆尺寸及晶圆种类

产品规格

适用晶圆尺寸	缺陷检出尺寸	应用范围
2 ~ 12吋硅晶圆 / 带框晶圆 / 第三代晶圆 / 玻璃晶圆等	> 0.5 μm	正面 / 背面 / 边缘

应用领域

大规模集成电路(LSI)、影像传感器(CIS)、微机电(MEMS)、LED、凸块(Bump)、直通硅晶穿孔(TSV)检测、电源芯片、功率组件(SiC)、氮化镓(GaN)、第三代半导体

Contact us

上海市浦东新区祖冲之路1077号2幢3201室
+86 (21) 6108 1858 #3121
marketing@spirox.com

